

中国科学技术大学先进技术研究院  
技术服务收费标准（初稿）

**芯片测试平台**

序号	测试名称	设备型号	单位	单价（元）
1	SEM-场发射	ZEISS Gemini-500	小时	1000
2	SEM-钨灯丝	ZEISS EVO-18	小时	500
3	电镜制样镀膜	Leica EM ACE600	颗	50
4	离子束切割	Leica EM TIC3X	小时	200
5	3D数字显微镜	ZEISS Smartzoom 5	小时	400
6	OM 光学显微镜	/	小时	200
7	EDS	OXFORD X-Max	小时	1000
8	EBSD	OXFORD C NANO	小时	1500
9	非定点研磨 截面	ALLIED	颗	700
10	定点研磨 截面	ALLIED	颗	1500
11	冷埋	/	颗	200
12	Delayer 去层（铜制程）	/	层	1500
13	Delayer 去层（铝制程）	/	层	400
14	去Sub层	/	层	200
15	Decap 一般封装	/	颗	100
16	Decap 特殊封装	/	颗	200
17	取Die（BGA/COB/PCB）	/	颗	200
18	取die（一般封装）	/	颗	100
19	P/N阱染色	/	颗	300
20	去除Bump	/	颗	100
21	弹坑实验	/	点	200
22	晶圆射频探针测试	MPI	小时	1000
23	网络分析仪	/	小时	300
24	示波器	/	小时	300
25	膜厚仪	/	小时	200
26	工程服务费	/	小时	500

**备注：**

- 1、以小时为计费标准的，最小计费单元为15Min，不足15Min按15Min收费，大于15Min小于30Min按30Min收费，以此类推；
- 2、实验过程中使用的耗材按成本单独计算；
- 3、表中价格为对外收费标准，对内价格享受优惠。